

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

鸿日达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位及人员 | 鸿日达2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 |
| 时间 | 2025年5月13日15:00-16:30 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易平台”（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目 |
| 公司接待人员姓名 | 主持人：鸿日达 董事长、总经理：王玉田先生 副总经理、董事会秘书：蔡飞鸣先生 财务总监：陈璎女士 独立董事：张建伟先生 独立董事：沈建中先生 保荐代表人：蔡晓涛先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1：公司 2024 年降本增效成果如何？下一步有何具体措施？</p> <p>答：2024 年公司主要通过提升产品良率、优化工艺路线、提高生产效率等方法降低成本。针对原材料价格上升引起的成本增加，公司在未来会通过套期保值业务稳定材料价格，降低材料成本，并持续通过推动精益生产模式优化产品成本。</p> <p>问题 2：2024 年公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计什么时候实施？</p> |

答：公司 2024 年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司将按照相关法律法规，在 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利润分配预案后的两个月内完成权益分派事宜。

问题 3： 公司未来发展重点在哪？ 2025 年有怎么样的预期？

答：在巩固传统业务和市场的基础上，公司未来将积极开拓新产品、新技术的发展空间。如利用 3D 打印技术拓展机构件和消费电子市场；通过封装级散热片努力填补国产供应链的空缺。

问题 4： 请介绍公司 3D 打印业务的发展情况？

答：公司目前已成功研制出能够打印钛合金、钢、铝等材料的 3D 打印设备，同时在全力攻关可打印铜材的另一款设备。鸿日达具备了从 3D 打印设备的机器制造、产品打印及后端加工（包括热处理、CNC、研磨、抛光、PVT 喷涂等）的全制程自研工艺的量产能力，可为客户提供从胚料到成品的一站式服务。公司运用 3D 打印技术制作的新产品已经开始对机构件和消费电子客户进行送样，正努力开辟传统业务新的增长空间。预期 2025 年有望进入部分项目的小批量量产阶段，实现营收层面零的突破。

问题 5： 请介绍公司半导体封装级散热片业务的发展情况？

答：公司已与多家国内主流的芯片设计公司、封装厂建立业务对接，并已部分完成工厂审核、样品验证导入，取得了若干核心客户的供应商代码（Vendor Code）。公司生产线于 2024 年末达至实现量产能力的新阶段。目前，公司已拥有具备量产能力的生产线 2 条，今年计划再增加 4 到 7 条产线。在全力拓展国内市场的同时，公司亦积极与海外客户沟通协作，努力寻求海外供应链的商机，争取切入更广阔的国际市场。在人工智能产业快速发展以及国产替代、自主可控的趋势下，半导体金属散热片业务有望成为公司新的核心增长点。

附件清单

无

| | |
|----|------------|
| 日期 | 2025年5月13日 |
|----|------------|